

CONSULTA PÚBLICA Nº 59, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012

A Secretária do Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de acordo com os artigos 8º e 9º da Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 170, de 4 de agosto de 2010, torna pública a proposta de alteração de Processo Produtivo Básico - PPB.

Manifestações podem ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, ao e-mail: [cgel.ppb@mdic.gov.br](mailto:cgel.ppb@mdic.gov.br)

HELOISA REGINA GUIMARÃES DE MENEZES

ANEXO

PROPOSTA 071/12: ALTERAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO PARA O PRODUTO MÁQUINA AUTOMÁTICA DIGITAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, COM TELA INCORPORADA - “ALL IN ONE”, ESTABELECIDO PELAS PORTARIAS INTERMINISTERIAIS Nº 53 E 54, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2012.

Obs: A PROPOSTA ESTÁ NO FORMATO DE PORTARIA (Versão da Lei de Informática)

Art. 1º O Processo Produtivo Básico para o produto MÁQUINA AUTOMÁTICA DIGITAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, COM TELA INCORPORADA - “ALL IN ONE”, industrializado no País, estabelecido pela Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 54, de 13 de fevereiro de 2012, passa a ser o seguinte:

I - montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuitos impresso;

II - montagem das partes elétricas e mecânicas; e

III - integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final. Parágrafo único. Desde que obedecido o Processo Produtivo Básico estabelecido nesta Portaria, as atividades ou operações inerentes às etapas de produção poderão ser realizadas por terceiros, exceto a etapa constante do inciso III, que não poderá ser objeto de terceirização.

Art. 2º Para o cumprimento do disposto no art. 1º ficam estabelecidos os seguintes percentuais e cronogramas de montagem no País e utilização de componentes, partes e peças, quando aplicáveis, tomando-se por base a quantidade utilizada, no ano calendário, considerando o disposto no art. 3º:

I - Placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implemente a função de processamento central (placa-mãe):

	Percentual
Montadas no País	90%

II - Placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implemente a função de interfaces de comunicação, quando estas não estiverem integradas à placa-mãe:

	Percentual
Montadas no País	90%

III - placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implementem a função interface de comunicação com tecnologia sem fio, de acordo com o seguinte cronograma:

Ano calendário	2012	2013	2014	2015 em diante
Montadas no País	20 %	50%	60%	80%

IV - placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implementem a função de fonte de tensão, quando forem internas e Conversores de Corrente Alternada/Corrente Contínua - CA/CC, quando forem externas:

Ano calendário	2012	2013	2014 em diante
Produzidos de acordo com o PPB específico	30%	50%	80%

V - cabos de força produzidos de acordo com o PPB específico ou, na ausência deste, a partir da trefilação e recozimento, observado o § 6º: 30% (trinta por cento);

VI - Unidades de disco magnético rígido, quando aplicável:

Ano calendário	2012	2013	2014 em diante
Produzidos de acordo com o PPB específico	20%	30%	50%

VII - Placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implementem as funções de memória (módulos de memórias RAM):

Ano calendário	2012	2013	2014 em diante
Produzidos de acordo com o PPB específico	50%	60%	80%
Montados no País	40%	30%	10%
Totais produzidos no País	90%	90%	90%

VIII - Demais componentes, partes e peças que atuem com a função de memória, quer sejam em forma de circuitos integrados, quer em forma de módulos ou placas, tais como os citados abaixo ou outras tecnologias, quando aplicável:

- a) Componente circuito integrado Nand Flash (FBGA- Fine pitch Ball Grid array / LGA- land grid array);
- b) Componente circuito integrado DRAM ou LPDRAM (FBGA);
- c) Componente eMMC (Multi Media Card) (FBGA / LGA);
- d) Componente eSSD (FBGA / LGA);
- e) Módulo SSD - (Small Form Factor Solid State Drive);

- f) Cartão de memória  $\mu$ SD card; e
- g) Unidade de armazenamento de dados SSD (Solid State Drive) com circuito integrado MCP (Multi Chip Package) denominado iSSD (Integrated Solid State Drive).

Ano calendário	2012	2013	2014	2015 em diante
Percentual mínimo exigido com PPB específico	-	30%	50%	60%

§ 1º A base de cálculo sobre a qual incidirão os percentuais será sobre o total de componentes e módulos, descritos no inciso VIII, que atuem com a função de memória, observando o disposto no §2º, ficando a critério do fabricante a opção de escolha para integrar nos percentuais estabelecidos.

§ 2º Para efeito de cumprimento dos percentuais definidos no inciso VIII deste artigo, os circuitos integrados de memórias deverão ser contabilizados individualmente, mesmo que apresentados em placas ou módulos com mais de um circuito integrado.

§ 3º Exclusivamente para o ano de 2012, ficam dispensadas da obrigatoriedade constante do inciso VIII as memórias do tipo: NAND Flash e LPDRAM sendo que, de 2013 em diante, deverão ser produzidas de acordo com o cronograma estabelecido no inciso VIII.

§ 4º As memórias do tipo MCP (Multi Chip Package - FBGA / LGA), deverão obedecer ao seguinte cronograma de exigência de percentuais mínimos obrigatórios:

Ano calendário	2012	2013	2014	2015	2016	2017 em diante
Percentual mínimo exigido com PPB específico	-	-	-	20%	40%	60%

§ 5º Ficam dispensadas das obrigatoriedades constantes deste inciso os seguintes chips de memória, presentes nas placas-mãe: Basic Input-Output system - BIOS; Graphics Double Data Rate - GDDR; e Cache.

§ 6º Caso a empresa fabricante opte por produzir os gabinetes a partir das etapas de fabricação do molde, injeção plástica e pintura, os percentuais exigidos neste inciso, poderão ser reduzidos em até 10 pontos percentuais.

§ 7º O cálculo dos novos percentuais de exigência reduzidos, referidos no § 3º será feito da seguinte forma:

$ER = EC - 10\% * (GF/PT)$ , onde:

ER = percentual de exigência reduzida;

EC = percentual de exigência corrente (inciso VII e VIII);

GF = quantidade de gabinetes fabricados;

PT = quantidade da produção total incentivada.

§ 8º Ficam dispensadas das obrigatoriedades constantes deste inciso os seguintes chips de memória, presentes nas placas-mãe: Basic Input-Output system - BIOS; Graphics Double Data Rate - GDDR; e Cache.

§ 9º Os cabos de força a que se refere o inciso V deste artigo deverão ser produzidos a partir da trefilação e recozimento, de acordo com o seguinte cronograma:

I - entre 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012: dispensado;

II - entre 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013: 60% (sessenta por cento), em peso;

III - entre 1º de janeiro de 2014 em diante: 90% (noventa por cento), em peso.

Art. 3º Caso os percentuais estabelecidos no art. 2º não sejam alcançados, a empresa ficará obrigada a compensar a diferença residual em relação ao percentual mínimo estabelecido, em unidades produzidas, até 31 de dezembro do ano seguinte, sem prejuízo das obrigações correntes, no ano-calendário.

Parágrafo único. A diferença residual a que se refere o caput não poderá exceder a 10% (dez por cento), tomando-se por base a produção do ano em que não foi possível atingir o limite estabelecido.

Art. 4º Ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos I e II do art. 1º os seguintes módulos, subconjuntos ou unidades:

I - unidade de discos magnéticos flexíveis;

II - unidade de disco óptico;

III - tela, inclusive com a estrutura de fixação com ou sem dispositivo de captura de imagem e/ou alto falantes incorporados, podendo conter, ou não, dispositivo sensível ao toque (touch screen);

IV - câmera de vídeo ou placa de circuito impresso montada com componentes elétricos ou eletrônicos que implemente a função de câmera de vídeo;

V - leitores de cartões, leitores biométricos, microfones e alto-falantes;

VI - placas e partes eletromecânicas sem função ativa, com ou sem filtros de sinal, com objetivo de suportar mecanicamente conectores, entradas de USB, diodos emissores de luz - LED (Light Emitting Diode), chaves liga-desliga ou cabos, utilizados unicamente como extensão de função já implementada na placa-mãe;

VII - subconjunto ventilador com dissipador; e

VIII - subconjuntos gabinete e base plástica, com blindagem eletromagnética ou insertos metálicos incorporados.

Art. 5º As empresas fabricantes deverão apresentar, no momento da habilitação prevista no Decreto no 5.906, de 2006, autorização de produção e/ou comercialização quando utilizadas a marca, patente, projeto ou tecnologia de propriedade de terceiros.

Art. 6º Anualmente, as empresas fabricantes deverão encaminhar à Secretaria de Política de Informática - SEPIN, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e à Secretaria do Desenvolvimento da Produção -SDP, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, até 31 de maio do ano posterior, relatório consolidado com as seguintes informações:

I - insumos adquiridos no mercado nacional e produzidos de acordo com seus respectivos Processos Produtivos Básicos;

II - identificação do fabricante fornecedor (Razão Social e CNPJ);

III - quantidade de MÁQUINA AUTOMÁTICA DIGITAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, COM TELA INCORPORADA - “ALL IN ONE”, comercializadas com e sem incentivos; e

IV - informações referentes à utilização dos percentuais, previstos nesta Portaria.

§ 1º As informações deverão ser encaminhadas em mídia digital (CD, DVD, Pendrive etc.) acompanhadas de uma correspondência com aviso de recebimento (AR).

§ 2º O não envio das informações acima citadas por parte da empresa, ressalvado o direito de defesa, bem como o não cumprimento dos percentuais estabelecidos nesta Portaria caracterizará o não cumprimento do Processo Produtivo Básico, ficando a empresa sujeita às penalidades previstas no art. 9º da Lei nº 8.248, de 1991, e no art. 36 do Decreto nº 5.906, de 2006.

Art. 7º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 54, de 13 de fevereiro de 2012.